

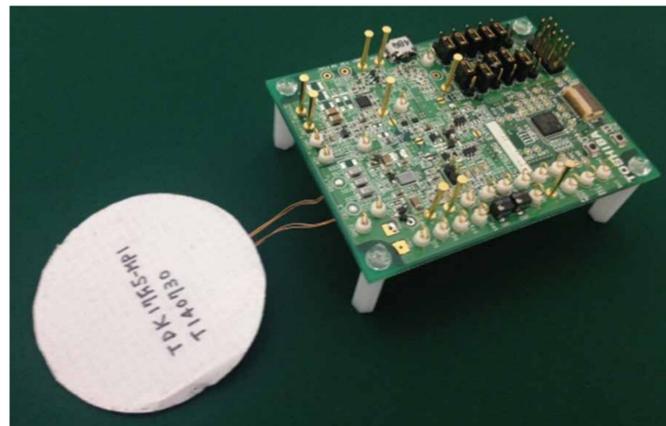
TOSHIBA

Leading Innovation >>>

无线功率传输

接收器ICTC7765WBG

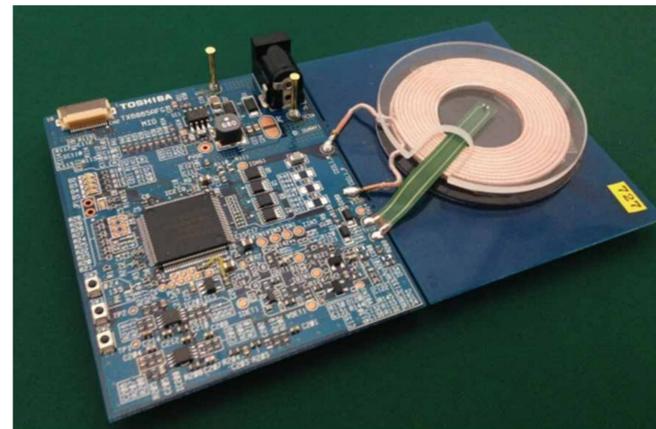
- > 采用WPC LP v1.1协议
- > 配备TB6865AFG (LP增强模式), 可实现10W输出
- > 为可调输出电压 (7、8、9和12V) 系列产品做准备
- > 可降低IC Ron (可有效提高效率与解决热平衡问题)
- > 使用外部电阻器控制FOD调节
- > 芯片尺寸小: 2.4mm x 3.67mm
- > 封装: WCSP28 (P0.5)



发送器TB6865ABG增强版

- > 采用WPC LP v1.1协议
- > ARM® Coretex® -M3
- > 采用TB6865AFG (装有LP增强模式软件)
- > 能输出15W的电能
- > VIN=19V
- > 实现了FOD检测功能
- > 封装: LQFP100_1414

+



=



TOSHIBA

Leading Innovation >>>

发射器集成电路产品

发射器端

TB6865AFG



- 采用ARM® Coretex®-M3
- LQFP100_1414
- 已量产
- 可为一个/两个智能手机充电

5W级单充设备类型

- 支持WPC LP v1.1协议
- 对应A11/A12和A14线圈
- 软件已安装
- VIN=5V全桥
- 实现了FOD检测功能
- 通过WPC认证
- 已量产



5W级类型

(成本削减版本)

- 支持WPC LP v1.1协议
- 用于A11线圈
- 软件已安装
- VIN=5V全桥
- 低成本版本 (通过减少部件等措施)

5W级类型

(适用于可穿戴式设备)

- 支持WPC LP v1.1协议
- 软件已安装
- VIN=5V全桥

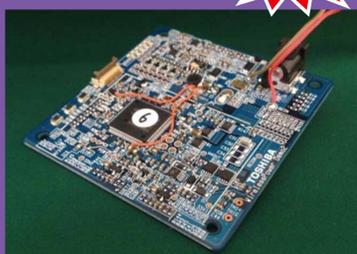
5W级双充设备类型

- 支持WPC LP v1.1协议
- 用于A11/A12线圈
- 软件已安装
- VIN=5V全桥
- 实现了FOD检测功能
- 正在展示中



15W级单充设备类型

- 基于WPC LP v1.1协议
- 软件已安装
- 我们的目标为实现15W解决方案
- VIN=19V全桥
- 实现了FOD检测功能
- 正在展示中



TB68xxAFG

- 用于Qi标准 (1.0版) 中所规定的中功率控制器
- 选用小尺寸封装 (目标为QFN48)
- 目标为于2015年第三季度推出样品

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

接收器集成电路产品

(((•))) 接收器端

TC7763WBG

5W级

- 支持WPC LP v1.1协议
- Vout=5V
- Iout=1A (最大值)
- 内置定序器
- FOD检测
- 效率高、产生热量低
- **通过了WPC认证**
- WCSP (2.4mm x 3.67mm)
- 已量产



TC7764WBG

5W级

- 支持WPC LP v1.1协议
- Vout=5V
- Iout=1A (最大值)
- **利用外部电阻器对FOD调节**
- 效率高、产生热量低
- WCSP (2.4mm x 3.67mm)
- 正在开发中
- SPL : 已准备就绪
- MP : 2015年05月 (目标)



TC7765WBG

10W级

- 基于WPC LP v1.1协议
- 能被外部MCU控制
- 可被外部MCU控制
- **为5W以上模式所选用的**
- **Vout=7V/8V/9V/12V的产品**
- 负载驱动器
- 使用外部电阻器控制FOD调节
- WCSP (2.4mm x 3.67mm)
- 正在开发中
- SPL : 2015年3月底
- MP : 2015年第3季度 (目标)

TC77xxWBG

15W级

- **基于WPC MP v1.0协议**
- 能被外部MCU控制
- 使用外部电阻器控制FOD调节
- WCSP (2.4mm x 3.67mm)
- 利用外部电阻器对FOD调节实现控制
- WCSP (2.4mm x 3.67mm)
- 正在开发中
- SPL : 2015年第4季度 (目标)

共振产品